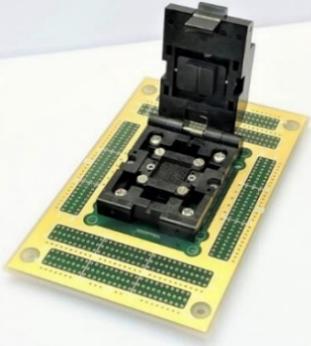
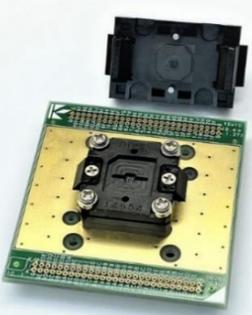


セミカスタムICソケット一覧

 <p>KASASAKU ELECTRONICS CO.,LTD.</p>				
製品名	001G	002G	003G	004G
実装できるICの最大外形寸法	タテ ヨコ 19mm×15mm	タテ ヨコ 16mm×9mm	タテ ヨコ 10mm×10mm	タテ ヨコ 10mm×10mm
ソケット外形寸法（基板設置寸法）	48mm×36mm	41mm×31mm	19.3mm×19.3mm	26.5mm×26.5mm
ソケット形状	クラムシェルタイプ	クラムシェルタイプ	蓋分離タイプ	クラムシェルタイプ
ピッチ	0.25mmピッチ～			
最大ピン数（グリッド） 0.4mm/0.5mm	0.4mm : 1360ピン (40×34) 0.5mm : 891ピン (33×27)	0.4mm : 760ピン (38×20) 0.5mm : 527ピン (31×17)	0.4mm : 324ピン (18×18) 0.5mm : 361ピン (19×19)	0.4mm : 324ピン (18×18) 0.5mm : 361ピン (19×19)
コンタクトピン	プローブピン、板バネピン、導電シート		プローブピン	
耐熱温度	-55℃～ +175℃			
納期(受注後)*1	実働5日～	実働3日～		実働5日～
特長	ソケットの外形が大きく、大小さまざまなPKGに対応可能です。	汎用性が高く、当社のソケットで一番主流の製品です。	蓋を分離式にすることでソケット外形を最も小さくでき、省スペースでの実装が可能です。	クラムシェルタイプで外形が最も小さく、省スペースでの実装が可能です。

*1.仕様と数量により変動がございます。